

Mate 2026

32nd Symposium on "Microjoining and Assembly Technology in Electronics"

<mate 論文執筆要項>

○論文体裁：WEB ページにリンクしているテンプレート(Word)をご利用下さい

○言 語：日本語または英語

○字 体：英語の字体(フォント)は Times が原則
日本語の字体は明朝体とする(題目は除く)

○題 目：本文が日本語の場合、日本語と英語 一段組
(字サイズ：14pt、字体：題目の字体はゴシック体)
※英文題目の各単語の先頭は、大文字とする(前置詞などは除く)

○著者名・所属：本文が日本語の場合、日本語と英語(字サイズ：9pt)

○Abstract：英語(60～120 words) 一段組(字サイズ：9pt)

○キーワード：英語、各単語の先頭は大文字(字サイズ：9pt)

○本 文：日本語または英語 二段組(字サイズ：9pt、字体：明朝体)
一段 23～25 文字、一頁 47 行(46～49 行)

○マージン：上 25mm, 下左右 20mm

○用 紙：A4 サイズ

○Figure および Table： 必ず英語の caption を付けること
また図表中の文字は全て英語表記とする

○ページ制限：4～6ページ最大

○参考文献：必要な参考文献を下記書式に沿って記載ください

(例)

- 1) 川戸祐一, 有村英俊, 工藤富雄, “フォトシンタリングを利用した導電性銅ナノインクの焼結とCu/ポリイミド界面の観察”, スマートプロセス学会誌, 2 (2013), pp.173-177.
- 2) P.S. James, H.W. Chandler, C.J. Newton, “The effect of mechanical loading on the contact resistance of coated aluminum”, A230 (1997), pp.194-201.
- 3) 梶原良一, 伊藤和利, 石居利明, “焼結 Ag 粒子ペーストを用いた鉛フリーパワー半導体パッケージの開発”, 第 16 回エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム論文集, 16(2010), pp.293-298.
- 4) C. Ehrhardt, M. Hutter, H. Oppermann, “Transient liquid phase soldering for lead-free joining of power modules in high temperature applications”, Proc. IMAPS International Conference and Exhibition on High Temperature Electronics, HiTEC 2012, Albuquerque, NM; United States; 8 May 2012-10 May 2012, pp.25-33.
- 5) 西岡利勝, 浜崎達也 編, プラスチック分析入門, 丸善, 2012, p.95.

○その他:

・pdf 版はカラーで問題ありませんが、印刷の仕上がりはモノクロ印刷です。

モノクロ印刷で容易に判別のつく図表を掲載ください。

・「新商品」や「新合金」などの論文にはふさわしくない表現は避け、再現性がある表現をしてください。